

Vodič a hrúbka medi na vonkajších a vnútorných vrstvách

Konštrukčné vyhotovenie DPS je rôzne a je charakterizované minimálnou šírkou plošných spojov, minimálnou šírkou izolačnej medzery, rozstupom spájkovacích bodov, veľkosťou spájkovacích plôšok alebo najmenším priemerom otvoru. Týmito parametrami je definovaná aj obtiažnosť výroby DPS. V konštrukčných triedach.

Plochy medi na jednotlivých vrstvách DPS musia byť rovnomerne rozložené. Rozdiel plochy jednej strany voči druhej môže byť maximálne 25%. Väčšia nerovnomernosť plôch spôsobuje nerovnomerné pokovovanie a krútenie základného materiálu.

Tabuľka konštrukčných tried v mm

Konštrukčná trieda	III	IV	V	VI	VII	VIII
Min. šírka vodiča v mm	0,4	0,3	0,2	0,15	0,125	0,1
Min. šírka izolačnej medz. v mm	0,4	0,3	0,2	0,15	0,125	0,1
Min. presah plôšky na polomere	0,4	0,3	0,2	0,15	0,125	0,1
Najmenší priemer vrtáka	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1

Vonkajšie vrstvy

Hrúbka medi v μm	Min. šírka vodiča	Tol. Vodiča na výslednej DPS	Min. šírka izolačná medzera	Tol. medzery na výslednej DPS
18	150	+20 -50	150	+50 -20
35	200	+20 -80	200	+80 -20
70	300	+30 -120	250	+120 -30
105	400	+50 -180	300	+180 -50

Poznámka: Výsledná hrúbka pokovovania vodivého obrazca je daná hrúbkou Cu základného materiálu + galvanicky vylúčenou vrstvou medi minimálne 20 μm + zvolená povrchová úprava.

Vnútorné vrstvy

Hrúbka medi v μm	Minimálna šírka vodiča	Min. šírka izolačnej medzery
18/18	180	150
35/35	200	200